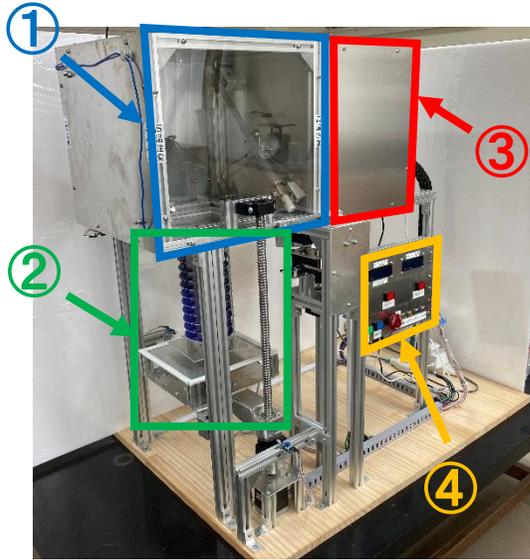


バッチ式成膜装置における熱処理工程の再現

～熱処理工程と温度制御の研究～

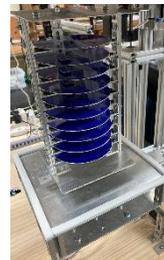
装置全体図



- ① 熱処理部
- ② 搬送部
- ③ 制御部
- ④ 操作部

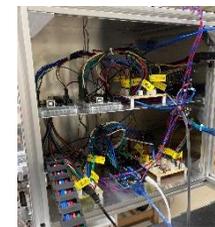
装置説明

搬送部(ポートエレベータ)



縦に重ねたウエハを上下移動させて熱処理部から出し入れする

制御部



モータ制御・温度制御の基盤が収納されている

操作部



- ・押しボタンで操作
- ・各工程でランプが点灯
- ・ヒーター温度がディスプレイに表示

バッチ式成膜装置とは？

一度に大量のウエハを熱処理することができる
半導体製造装置

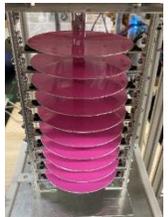
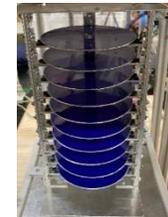


研究ではバッチ式成膜装置の熱処理工程を再現

熱処理部



ウエハをヒーターで加熱する
(ヒーター温度は100°C)



ウエハの表面に張ってある「示温シール」の色を変化させる。